



[テキストを入力]



\*\*\*\*\*

“AUTOMOTIVE WORLD 2020”

## 第 12 届 日本国际汽车电子技术展 参展

敬请莅临我司展位

\*\*\*\*\*

各位

承蒙关照，深表感谢。

恭祝贵司事业蒸蒸日上，一帆风顺！

此次我司参展“第 11 届 日本国际汽车电子技术展”，敬请各位莅临参观我司展位。

我司将会展示「高耐热性大功率半导体模块用灌封树脂」、「热传导性树脂的热模拟解析」、「热传导性聚氨酯灌封树脂」、「基材防湿保型涂料」、「常温固化型 导电性能粘接剂」的最新技术，期待您的光临。

需要入场邀请券，或希望详细商谈的贵宾请与我司销售部门联系或访问我司官网点击“联系我们”。

衷心的期待您的到来。

谢谢！

日 期：2020年1月15日（星期三）～17日（星期五）10点至18点  
17日17点为止

会 场： TOKYO BIG SIGHT  
青海展示场 「A12-21」

出展商： 朋诺株式会社 (Pelnox, Ltd.)